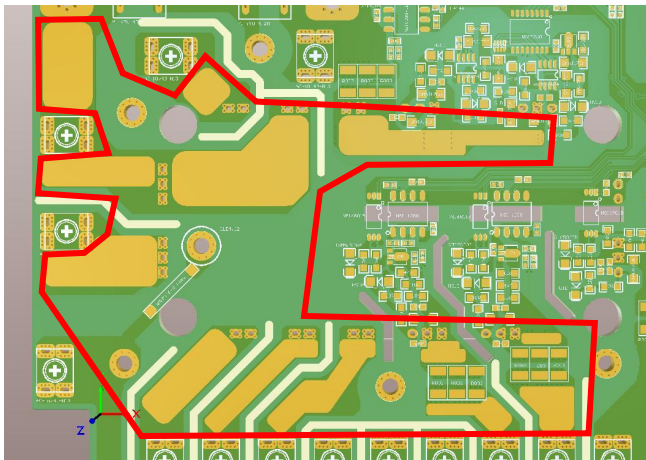
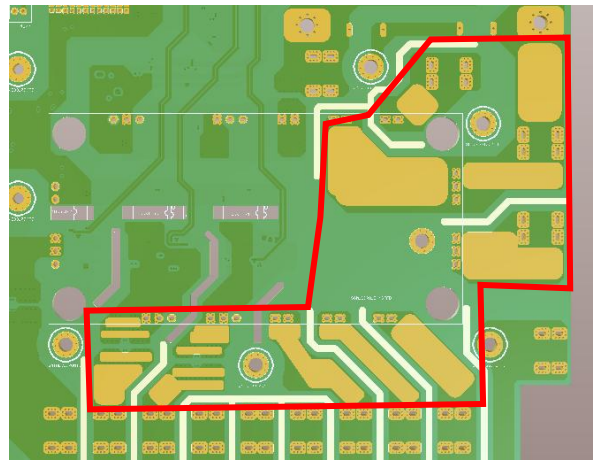


PCB 焊接工艺要求	产品名称	产品型号	版本	页数	制定时间
	交流伺服	MDC15K_POW_V2	V2	1/1	2026-4-7

1. 所有元件紧贴线路板焊接；
2. Q1 的方框对应有字的一面；
3. 板子正面和背面的大实体焊盘 需要加锡，厚度不低于 0.2mm，位置如下图红色方框内的大焊盘；



线路板正面



线路板背面

4. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	